

無電解銅めっき+フラッシュ銅めっき連続プロセス ELFプロセス

*特許出願中

マイクロビア、スタックビアにも有効な
無電解銅めっき+フラッシュ銅めっきを連続で行うプロセス
“ELF (エルフ) プロセス”を開発致しました。

ElectroLess Copper + Flash Copper Process = ELF Process

※めっき厚…無電解銅めっき：0.1~0.2 μ m フラッシュ銅めっき：0.8~0.9 μ m

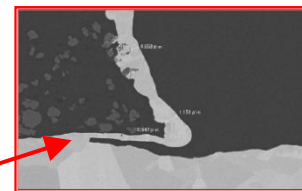
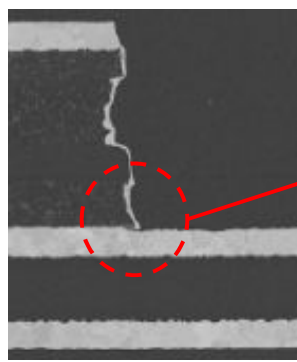
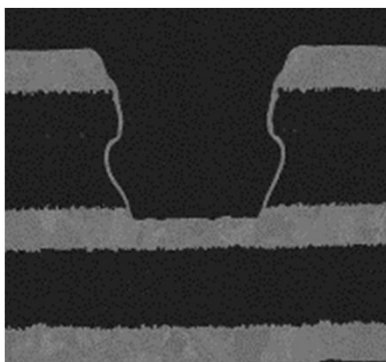
【ELFプロセスの特徴】

- ▶ 縦型搬送方式により両面ビア品に効果大
- ▶ マイクロビアやスタックビアに対するカバーリング性能の大幅UP
- ▶ HA箔対応プロセスにより、歩留まり大幅UPが可能
- ▶ 1.0 μ mめっき厚による信頼性&歩留まりの大幅UP

・処理例

3層FPC ビアホール品 (ビア径：50 μ mφ ビア深さ：39 μ m)

ビア壁層構成…Cu/PI/BS/Cu



めっき付きまわり性を
大幅に向上しました

無電解銅めっき0.1 μ m + フラッシュ銅めっき0.9 μ m処理後

・装置外観 (弊社所有 RTR型ELFプロセス装置)



- ・ 工程は大気圧プラズマ処理を標準装備
- ・ 投入方法は縦・水平いずれでも可能
- ・ RTR&SBSとも常時見学可能
- ・ **評価テスト随時受付中**

*** 是非お問い合わせください ***